

“指纹芯片一哥”加速调整 多元化发展难题待解

本报记者 陈佳岚 广州报道

当前，“指纹芯片一哥”深圳市汇顶科技股份有限公司(603160.SH,以下简称“汇顶科技”)正加速调整。

近日，汇顶科技发布公告称，2025年2月10日，汇顶香港和Tessolve已签署交割协议，确认《股

份购买与转让协议》约定交割行动已完成，自交割日起，汇顶香港不再享有标的公司DCT GmbH(以下简称“DCT资产组”)股东权利和承担标的公司股东责任。

汇顶科技方面表示，本次交易是根据公司战略发展规划和业务布局调整，有助于整合公司资源，

优化公司组织架构，提高资产使用效率。同时鉴于DCT资产组所涉产品与公司其他产品协同效应不强，此次交易不会对公司日常生产经营业务产生不利影响。

《中国经营报》记者注意到，汇顶科技在出售DCT GmbH之前，已经连续出售Silicon Radar、格理

德国等资产，此外也公告了收购云英谷进入显示驱动芯片领域的计划。在收缩与扩张并存的资本运作背后，汇顶科技是出于怎样的战略考量？如何平衡短期财务压力与长期技术投入？记者也就相关问题联系采访汇顶科技方面，截至发稿，暂未获得回复。

完成出售旗下半导体公司

如今汇顶科技拟对外出售DCT资产组，意味着公司将剥离这一亏损业务。

汇顶科技方面披露，汇顶香港已于2025年2月7日收到Tessolve支付的3009.5万欧元(约合人民币2.29亿元)首期转让对价款。Tessolve尚有剩余转让对价未支付，剩余转让对价基准金额为1062.5万欧元(约合人民币8089万元)，剩余实际转让对价的支付金额将在剩余基准金额基础上根据标的公司2024年及2025年上半年的营业收入及交割日的营运资金和净负债情况进行调整。

这也意味着，汇顶科技出售DCT资产组的初始交易价格为4250万欧元，但最终实际交易价格可能会根据上述调整机制有所不同。

公开资料显示，DCT GmbH成立于2009年10月，注册于德国，2020年8月，汇顶香港以3950万欧元的现金对价收购DCT资产组100%的股权。DCT GmbH拥有一支优秀的图像信号处理(ISP)的研发团队，在超大规模系统级芯片(SoCs)、FPGA、嵌入式软件和系统等领域技术实力深厚。此举一度被汇顶科技认为是冲击智能终端和汽车电子市场的重要举措。

然而，这项曾被汇顶科技寄予厚望的资产近年来却陷入亏损。



汇顶科技历年营收及各产品业务增长情况。

2023年全年，DCT资产组实现营收1882.85万欧元，净利润为-236万欧元。2024年前三季度，DCT资产组的营收为1019.83万欧元，净利润为-130万欧元。如今汇顶科技拟对外出售DCT资产组，意味着公司将剥离这一亏损业务。

汇顶科技成立于2002年，最初主营业务是固定电话IC芯片，随着固定电话市场逐渐萎缩，汇顶科技面临业务转型的挑战。

2006年，汇顶科技开始研究电容触控技术，到了2011年，随着智能手机和平板电脑市场的高速发展，其电容屏触控芯片销量快速提升，随后到了2014年，公司又开始进军指纹芯片市场。在指纹识

别芯片市场增长的推动下，汇顶科技市值在2020年2月底猛涨到1700亿元，还被冠上了“指纹芯片一哥”的称号。然而好景不长，由于指纹识别芯片产品竞争加剧，出货量与销售价格承压以及消费需求疲软的影响，汇顶科技在2022年陷入亏损，总市值也一度跌至不足300亿元。Wind数据显示，2019年至2023年，汇顶科技指纹识别芯片的收入占比从83.6%降至42.87%。

不过，随着2023年第二季度行业去库存与消费电子景气度复苏，汇顶科技的业绩营收也出现了反弹。

财报显示，2023年，汇顶科技

实现营业收入44.08亿元，同比增长30.26%；净利润达到1.65亿元，同比增长122.08%，成功扭亏为盈。与此同时，汇顶科技最新披露的业绩预告显示，预计公司2024年年度实现营业收入43.7亿元左右，同比下降0.86%左右，归母净利润为5.5亿元到6.4亿元，同比增长233.22%到287.75%。汇顶科技方面解释，主要是报告期内公司超声波指纹、新一代光线传感器及NFC/eSE等新产品实现在品牌客户端的批量出货，得益于芯片采购成本下降及公司对现有产品迭代产生的积极影响，产品成本有所下降，毛利率水平得到有效提升。

多元化发展情况待观察

汇顶科技寄希望于转型和布局新产品，通过并购横向扩展更多业务范围。

由于以指纹识别芯片和触控芯片为主的核心业务高度依赖智能手机市场。汇顶科技也寄希望于转型和布局新领域，并购横向扩展更多业务范围。

在2020年8月收购DCT资产之前，汇顶科技在2018年就以900万欧元现金收购了半导体蜂窝IP提供商——格理德有限责任公司(Commsolid GmbH)，进军NB-IoT(窄带物联网)领域；同年2月又斥资1.65亿美元收购美股半导体巨头NXP(恩智浦半导体)旗下的VAS(语音及音频应用解决方案)业务，主攻智能语音芯片。

由于市场环境变化及业务协同效应不强，汇顶科技投资收购的部分业务进展不及预期，2022年12月，汇顶科技以767.86万美元(含出售交易对方部分股票变现所得约404.08万美元)对外出售参股公司Silicon Radar GmbH 24%的股权；2023年2月，汇顶科技对外出售全资孙公司格理德有限责任公司100%股权，交易对价为7500欧元(约合人民币5.22万元)。如今，又将出售DCT资产组。

从业务构成来看，汇顶科技当前主要产品包含指纹识别芯片、触控芯片及其他芯片，截至2023年年底，汇顶科技仍有近八成的业务收入依赖指纹识别芯片和触控芯片。

然而，汇顶科技仍在持续并购，2024年12月宣布拟收购云英谷科技100%股权，进军显示驱动芯片领域。云英谷科技是一家集AMOLED显示驱动芯片、Micro OLED/Micro LED微显示芯片和显示技术IP授权的芯片设计企业，旗下AMOLED显示驱动芯片下游应用终端为智能手机，而Micro OLED硅基显示驱动背板芯片主要的下游应用终端则为VR/AR等智能头戴式设备。据Omdia数据，2024年第一季度，云英谷在AMOLED DDIC(显示驱动芯

片)市场的市场占有率为5.5%，仅次于三星、瑞鼎科技等，是国内的龙头企业。Omdia显示驱动IC研究高级分析师蒋与杨(Queenie Jiang)对记者分析，从2025年开始，AMOLED智能手机显示驱动芯片需求将以每年5%左右的速度增长。而苹果的入局，将加速OLED平板电脑和笔记本电脑显示驱动芯片需求的增长。

兴业证券分析师姚康认为，本次收购有利于汇顶科技形成OLED触控+显示驱动的完整解决方案能力，打造更强综合竞争力。也有芯片设计行业人士向记者分析，自2024年以来，随着智能手机市场的逐渐复苏，特别是折叠屏手机的爆发，OLED面板的需求保持持续增长，这将在一定程度上推动OLED驱动芯片的需求增加。汇顶科技原本在指纹识别领域有优势，但市场竞争可能加剧，增长空间有限，所以通过收购进入新市场，这可能是个好策略。不过显示驱动芯片市场本身竞争也很激烈，有联咏、三星这样的巨头，汇顶科技能否分得一杯羹，还需观察。

由于市场竞争加剧，OLED驱动芯片价格下滑，云英谷业绩呈现“增收不增利”的现象。财报显示，云英谷2022年营收5.52亿元，净亏损1亿元；2023年营收7.21亿元，净亏损2.58亿元；2024年前三季度营收7.05亿元，净亏损1.62亿元。“从供需来看，未来两年AMOLED显示驱动芯片市场仍将处在供过于求的状态，所以价格竞争仍将存在。”蒋与杨表示。

截至2025年2月19日收盘，汇顶科技股价为81.62元/股，总市值约为376.97亿元，与昔日1700亿元市值高光时刻相去甚远，而对于未来新业务何时能够为汇顶科技贡献更多元化的业务表现，何时能迎来高增长仍需持续观察。

营收新高VS利润下滑 中国晶圆代工三巨头的“冰火叙事”

本报记者 李玉洋 上海报道

当全球半导体产业正在为AI大模型所引发的浪潮狂欢时，中国三大晶圆代工厂则勾勒出另一幅产业图景。

日前，中芯国际(688981.SH、00981.HK)、华虹半导体(01347.HK)和晶合集成(688249.SH)相继披露2024年财报或业绩预告。2024年，

中芯国际实现营收80.3亿美元(约合人民币577.96亿元)，进一步巩固了其全球第二大纯晶圆代工厂的地位；主攻特色工艺的华虹半导体全年营收20亿美元，同比下降12%，主要是平均销售价格下降所致。

国产大模型“黑马”DeepSeek在春节期间的一炮而红，带来AI模型训练降本的机会，非顶尖算力机构也有机会打入AI核心产业链。于

是，近期芯片股涨势扩大，中芯国际最高报51港元/股，再创新高，华虹公司涨超15%，也创下历史新高。而专精于DDIC(面板显示驱动芯片)的晶合集成则公告称，预计2024年实现营业收入90.2亿元到94.7亿元，同比上升24.52%到30.74%。

“中芯国际2024年全年收入首次突破80亿美元，这是最大的亮点。”电子创新网CEO张国斌告诉

《中国经营报》记者。在复盘国内晶圆代工业2024年的整体表现时，他认为：“营收稳步增长，代工业务呈现多元化发展，同时积极投资扩产保持良好发展后劲。”

根据市场研究机构TrendForce集邦咨询的数据，截至2024年第三季度，中芯国际、华虹半导体和晶合集成在全球晶圆代工市场的排名分别为第三、第六和第十名。

工业龙头，中芯国际2024年全年营收增长确立了其全球第二大纯晶圆厂，这具有里程碑意义。

“2024年第四季度的营业收入、营业利润、利润总额较上年同期增加，说明在代工业务方面，中芯国际已经挑起了大梁，成为中国半导体产业的中坚力量。从销售贡献看，智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴成为业务重要来源。”他补充道。

财报显示，中芯国际销售收入按应用分，来自智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车的占比分别为28%、16%、38%、10%和8%，受益于诸多因素及国家刺激消费政策的带

动，消费电子、智能手机等应用收入有大幅增长；按晶圆尺寸划分，来自12英寸和8英寸的收入均有增长，其中12英寸收入同比增长35%，主要得益于产能规模的扩大以及新增产能较快完成验证并投入生产。

对于中芯国际财报的亮点，张国斌还指出，该公司全年出货量超过800万片，年平均产能利用率高达85.6%。这一高产能利用率反映了公司的高效运营能力。“此外，公司在智能手机芯片业务上收入暴增超40亿元，增幅达37%，在平板、汽车领域都有良好表现，表明代工业务逐步成熟稳定。”他说。

记者注意到，白鹏在主持财报会时透露，华虹半导体将由55nm和65nm及以上工艺节点，向小的工艺节点发展。“华虹半导体始终以成熟节点的特色工艺为专长，但是成熟节点的含义随着时间而发生变化，几年前成熟节点的界限为40nm，我认为在接下来几年成熟节点界限将是28nm，甚至22nm。”白鹏表示，“如果我们的市场需求向更小的工艺节点发展，我们一定会将工艺节点发展至28nm及22nm。”



中芯国际2024年全年收入首次突破80亿美元，巩固了其全球第二大纯晶圆代工厂的地位。
李玉洋/摄影

“淡季不淡”

成立于2015年5月的晶合集成，在2023年5月上市，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司立足于液晶面板显示驱动芯片(DDIC)代工，在DDIC代工领域市场占有率为全球领先。

根据此前公告，晶合集成预计2024年实现营业收入90.2亿元到94.7亿元，同比上升24.52%到30.74%；预计实现归属于母公司所有者的净利润4.55亿元到5.9亿元，同比上升115.00%到178.79%。

对业绩变化，该公司提到，随着行业景气度逐渐回升，公司整体产能利用率维持高位水平，助益公司营业收入和产品毛利率水平稳步提升。

此外，晶合集成管理层也有人事变动。2月13日晚间，晶合集成发布公告称，因个人及家庭原因，蔡辉嘉申请辞去公司总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。离职后，蔡辉嘉先生将不再担任公司任何职务。

公告称，蔡辉嘉在任职期间所参与研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。

中芯国际净利润同比下滑45.4%；华虹半导体由于平均销售价格下降，全年营收20亿美

元，同比下降12%；晶合集成以最高178.8%的净利润增速逆势突围……这就是2024年，中国三大晶圆代工厂的财报所勾勒出的一幅产业图景。

而对于2025年第一季度的业绩指引，中芯国际方面表示，预计一季度销售收入环比增长6%至8%，毛利率介于19%至21%的范围内。

“2025年我们看到的急单很多。”赵海军说。据他分析，一方面是出于对国际政策不稳定的考虑，客户提早备货；另一方面则是中国市场出台了手机、电脑相关的激励政策。

而华虹半导体认为2025年一季度的销售收入在5.3亿美元至5.5亿美元，毛利率9%至11%。由于华虹半导体的新建12英寸生产线于2024年年底投产，折旧将从2025年开始，这将一定程度侵蚀公司的利润。

国内两大晶圆代工厂的业绩预期，都显示出今年一季度是“淡季不淡”。TrendForce集邦咨询钟映廷分析师表示：“2025年第一季度产能利用率优于预期，主要来自地缘因素及政策刺激的影响，但Foundry厂商仍担忧下半年的动能，需持续观察此需求变化情况。”